



股票代码 0580.HK

# 企业通讯

2025年第三季度

# 股价信息

---

2025年9月30日

---

收盘价 ( 港元 )	1.94
总市值 ( 亿港元 )	30.91
市盈率PE ( TTM )	17.50
市净率PB	1.488

---

## 第三季度

股价最高价 ( 港元 )	1.97
股价最低价 ( 港元 )	1.19
平均交易量 ( 万股 )	840.89
平均交易金额 ( 万港元 )	1368.18

---

## 2025年第三季度



# 特高压及重大项目信息

项目名称	技术类型	电压等级kV	截至目前项目进展
陇东-山东	常规	± 800KV	已完成交付
金上-湖北	常规	± 800KV	已完成交付
哈密-重庆	常规	± 800KV	已完成交付
宁夏-湖南	常规	± 800KV	已完成交付
陕西-安徽	常规	± 800KV	订单交付中
甘肃-浙江	柔性	± 800KV	订单交付中
沙特中南	柔性	± 500KV	订单交付中
藏东南-粤港澳大湾区	柔性	± 800KV	已启动，待设备招标
蒙西-京津冀	混合	± 800KV	已启动，待设备招标
巴西美利山三期	常规	± 800KV	部分合同已签署
疆电（南疆）送电川渝	柔性	± 800KV	环评已公示
巴丹吉林-四川	混合	± 800KV	可研工作已完成
陕西-河南	混合	± 800KV	环评已受理
库布齐-上海	未公布 （以柔性为主）	± 800KV	前期工作推进中
腾格里-江西		± 800KV	前期工作推进中
乌兰布和-京津冀鲁		± 800KV	前期工作推进中
内蒙古-江苏		± 800KV	前期工作推进中
柴达木-广西		± 800KV	前期工作推进中
松辽-华北		± 800KV	前期工作推进中
内蒙古-华东		± 800KV	前期工作推进中
青海海南外送		± 800KV	前期工作推进中

# 新闻目录

1. 赛晶科技2025年中期业绩公布，归母净利润飙升178%
2. 赛晶半导体收购湖南虹安
3. 科创双擎 | 智启芯程 赛晶半导体与湖南三安签署战略合作协议
4. 国重项目研发成果“ZCMJ2.8-9000型全国产化干式直流支撑电容器”通过新产品鉴定
5. 喜讯！赛晶牵头编制的柔性直流输电领域材料团体标准通过报批稿评审
6. Astrol再获核聚变脉冲电源订单
7. 赛晶固态直流断路器护航海上风电安装船，引领行业绿色升级
8. 赛晶电力电容器再传捷报，三揽国网集中规模招标项目
9. 赛晶科技亮相雁栖能源论坛，展示直流支撑电容器尖端成果
10. 创新驱动，绿色未来——赛晶科技参加PCIM Asia 2025
11. 赛晶半导体携“芯”技术参加IPF 2025

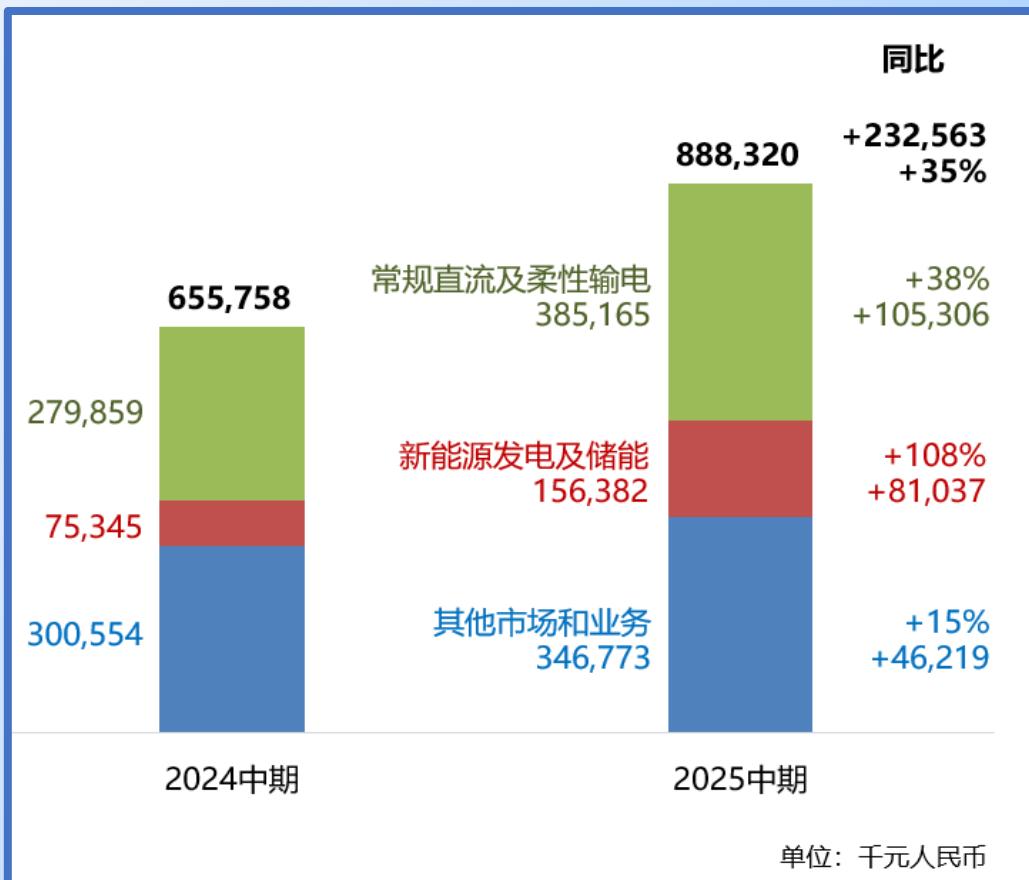
# 新产品发布

1. i23系列微沟槽栅IGBT芯片
2. 1200V i23 ED封装半桥IGBT模块
3. 1700V i20 TF封装半桥IGBT模块
4. 1700V 900A i23 ED封装半桥IGBT模块
5. 1200V 200A /300A ST封装半桥IGBT模块

## 赛晶科技2025年中期业绩公布 归母净利润飙升178%

2025年8月25日，赛晶科技集团有限公司（以下简称：“本集团”或“赛晶科技”）举行了2025年中期业绩线上发布会，就上半年财务及经营表现进行了全面解读，关键业绩数据如下：

- 销售收入8.88亿元人民币，较2024年同期增长约35%；
- 归母净利润9377万元人民币，较2024年同期增长178%；
- 净利润率9.6%，同比增加6.4个百分点；
- 基本每股收益5.85分人民币，同比增长180%；
- 2025年中期分红派息1港仙/每股，去年同期未派息。



## 柔性输电工程密集交付，收入大幅增长

在2025上半年中，柔性输电相关订单收入大幅增长，主要得益于2024年启动的陕西-安徽、甘肃-浙江、沙特中南项目，在2025年部分订单陆续开始交付。展望未来，增长动能持续充沛：2025年多个项目有望获批。其中藏东南-粤港澳大湾区、蒙西-京津冀项目已获核准，待招标启动；巴西美利山三期项目已由国网中标，待正式招标程序启动；疆电（南疆）送电川渝、巴丹吉林-四川等项目也有望于年底前核准。

序号	项目名称	技术类型	电压等级	启动年份	2025年进展
1	陇东-山东	常规	±800KV		2024年已完成，无进展
2	宁夏-湖南	常规	±800KV	2023	剩余订单完成交付
3	哈密-重庆	常规	±800KV		
4	金上-湖北	常规	±800KV		
5	陕西-安徽	常规	±800KV		
6	甘肃-浙江	柔性	±800KV	2024	部分订单交付
7	沙特中南	柔性	±500KV		
8	藏东南-粤港澳大湾区	柔性	±800KV		项目已核准待招标
9	蒙西-京津冀	混合	±800KV		
10	巴西美利山三期	常规	±800KV	2025 (预测)	国网已中标待招标
11	疆电（南疆）送电川渝	柔性	±800KV		年底前有望核准
12	巴丹吉林-四川	混合	±800KV		
13	陕西-河南	混合	±800KV		待定

“十五五”待建特高压直流项目众多，“十六五”新需求显现。长远的看，“十五五”期间还将有数个项目规划推进。特别值得关注的是：作为雅江水电站配套外送工程，预计将在“十六五”期间启动，将有望启动8-12个柔直或混合项目。这一庞大且清晰的项目梯队，为公司未来数年的业绩提供了坚实且可持续的保障。

序号	项目名称	技术类型	电压等级	展望
1	库布齐-上海	未公布 (以柔性为主)	±800KV	十五五 期间
2	腾格里-江西		±800KV	
3	乌兰布和-邯郸		±800KV	
4	内蒙古-江苏		±800KV	
5	柴达木-广西		±800KV	
6	松辽-华北		±800KV	
7	内蒙古-华东		±800KV	
8	青海-桂林		±800KV	
...	其他项目		±800KV	
雅江水电站 配套外送工程 (8至12个项目)		待规划 (以柔性为主)	±800KV ±1100KV	十六五 期间

海风并网、改造更新、电网互联、柔性交流，多种需求百花齐放。各种创新技术和应用场景不断涌现，2025年上半年分别有扬州-镇江直流输电二期、巴西伊泰普水电站直流送出、智利/秘鲁DPFC、中广核嵊泗海上风电送出项目等订单正在交付中，另外今年还有上海电气山东半岛海风、华能山东海上风电等诸多项目待启动。

## 新产品不断推出，自研功率半导体步入增长通道

在自研功率半导体方面，本集团陆续完成多款自研半导体新产品研发，进一步丰富了产品种类，扩展了下游市场需求的覆盖范围。2025年上半年的新产品包括：采用微沟槽设计的第七代i23系列IGBT芯片，及采用该芯片的ED封装IGBT模块，和FP封装、EP封装、TF封装等多款IGBT模块新产品。在SiC芯片方面，自研SiC芯片已经到达国际领先水平的1200V/ 13mΩ，HEEV封装、EVD封装模块，参数低至2mΩ至4mΩ，保持领先地位。



本集团的自研功率半导体业务，继续保持良好的发展形势。2025年上半年销售收入达53,135千元人民币，同比增长23%，环比增长23%。得益于客户群体及订单规模增长，1700V新产品销量增长。2025全年，自研功率半导体全年目标销售收入1.5亿元人民币。

## 多项技术国际领先，市场潜力初显

在本集团凭借多项全球领先技术，展现出巨大的市场潜力。旗下固态直流断路器产品已斩获全球三大船级社认证，并成功应用于中国、欧洲等多个重大试验示范项目。作为世界首款覆盖1至3KV / 电流最高至5KA的固态直流断路器，其具备国际领先的微秒级开关速度，已与西门子海事、康士伯海事、中船重工等国际知名企业建立合作。



图5：固态直流断路器

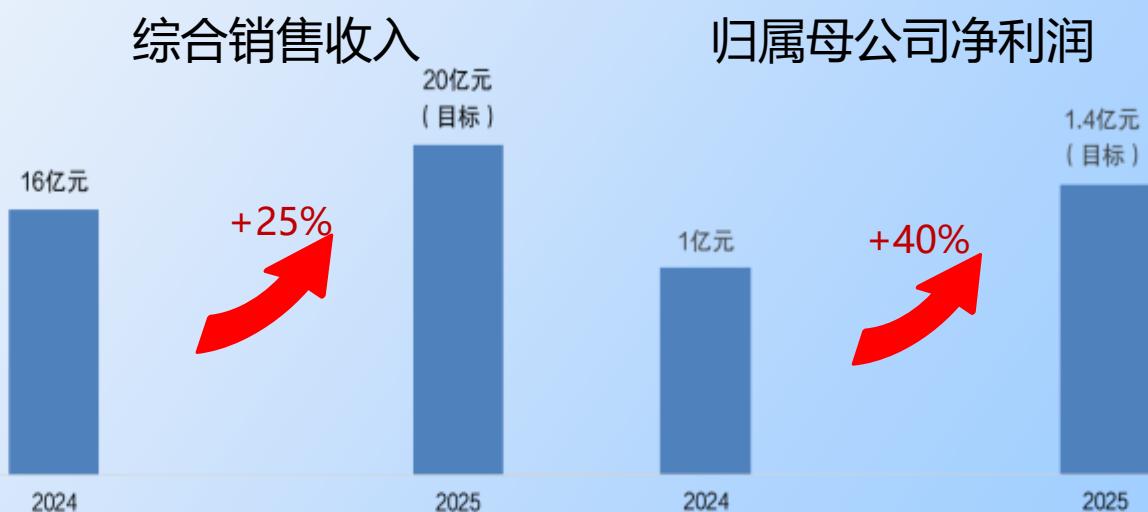


图6：脉冲功率开关

同时，集团在脉冲功率开关领域拥有国际领先技术，自成立以来已成功交付80多个相关项目，应用场景覆盖核聚变领域、高能粒子科研、雷达系统、水下探索、高压实验室等尖端领域。产品电压高达100千伏，电流额定值具有可扩展性，通常在几十甚至几百千安范围内。作为核心解决方案提供者，集团可提供基于晶闸管、高  $dI/dt$  晶闸管、集成门极换流晶闸管（IGCT）、以及Hipak(IGBT)、Stakpak(IGBT) 及 Linpak(IGBT)为核心的多种产品和方案，并可以根据不同需求定制化开发。

## 特高压+半导体双轮驱动，全年营收目标20亿

展望未来，赛晶科技将抓紧全球能源转型战略机遇，深度参与国内外特高压电网建设，持续巩固电网输配电业务的增长态势。集团将继续推进自研功率半导体产品的技术研发和市场开拓，力争实现销售收入的进一步增长。同时，本集团将同步推动固态开关、脉冲功率开关等前沿技术在电气化船舶、可控核聚变等新兴领域的市场开拓，从而为本集团业务的长期发展奠定良好基础。此外，本集团将着力提升各项经营管理水平，全力加强营销开拓，确保实现2025年销售收入人民币20亿元、归母净利润人民币1.4亿元的经营目标。



[返回目录](#)

## 赛晶半导体收购湖南虹安

2025年7月11日，赛晶半导体及现有股东与创鑫云（厦门）科技投资有限公司、崇竣科技有限公司、港湾亚洲资本有限公司、协芯科技有限公司（简称“投资者”）正式签署增资协议。

- 赛晶半导体增加注册资本420.6136万美元，投资者将以其在湖南虹安的100%股权出资认购，合计占赛晶半导体经扩大后股权的9%。
- 此次股权变动后，赛晶半导体的注册资本由42,528,706美元增加至46,734,842美元，本集团于赛晶半导体的股权比例由约70.54%降至64.19%，赛晶半导体的股权变化不会影响本集团的控制权，赛晶半导体仍为本集团的附属公司。

**Sun.King Technology Group Limited**

**赛晶科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：580)

須予披露交易 -

視作出售賽晶半導體的股權及收購湖南虹安的股權

### 背景

於二零二五年七月十一日(交易時段後)，賽晶半導體及現有股東與投資者簽署增資協議。據此，賽晶半導體將發行及投資者將按認購價認購賽晶半導體的新增註冊資本，合共相當於賽晶半導體經擴大股權約9.00%，認購價將由投資者據根據股權轉讓協議以轉讓湖南虹安全部股權予賽晶半導體的方式償付。增資協議交割後，賽晶半導體的註冊資本將由42,528,706美元增加至46,734,842美元，而本公司於賽晶半導體的股權比例按經擴大基準計算將由約70.5406%降至約64.1918%。本公司於賽晶半導體的股權變化不會影響本公司對其控制。根據增資協議擬向投資者發行新增註冊資本後，賽晶半導體仍為本公司的附屬公司。

於二零二五年七月十一日(交易時段後)，賽晶半導體與投資者簽署股權轉讓協議。據此，賽晶半導體將收購及投資者將出售湖南虹安的全部股權，總代價為人民幣180,000,000元，將由賽晶半導體根據增資協議以發行相當於賽晶半導體經擴大股權約9.00%的新增註冊資本予投資者的方式償付。

返回目录

## 科创双擎 | 智启芯程 赛晶半导体与湖南三安签署战略合作协议

2025年9月12日，赛晶亚太半导体科技(浙江)有限公司（以下简称“赛晶半导体”）与湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）在湖南三安总部成功举行战略合作签约仪式。双方基于在新型功率半导体产业生态中的互补优势，正式建立全面战略合作伙伴关系，共同聚焦碳化硅与氮化镓等宽禁带半导体技术的研发与产业化应用，助力全球能源革命与工业升级。



此次战略合作，双方将整合优势资源，聚焦新一代功率半导体技术研发、产能协同与市场共创，携手打造安全可控、具有国际竞争力的高端功率半导体产业链，为全球绿色低碳转型提供科技支撑。

[返回目录](#)

# 国重项目研发成果“ZCMJ2.8-9000型全国产化干式直流支撑电容器”通过新产品鉴定

2025年8月18日，赛晶科技集团迎来重要里程碑，旗下成员无锡赛晶电力电容器有限公司与嘉善赛晶电容器有限公司联合研发的“ZCMJ2.8-9000型全国产化干式直流支撑电容器”顺利通过新产品鉴定。



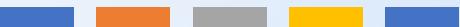
本次鉴定的顺利通过，标志着赛晶科技在高端电力电容器领域取得重大技术突破，增强了赛晶科技在国内外市场的核心竞争力，为我们持续引领行业技术变革、实现高质量发展注入了强劲动力。结合公司在特高压柔性直流输电工程中持续扩大的市场贡献，赛晶充分展现了从前沿技术研发到重大工程应用的全面能力，体现出企业深度融入国家能源战略、服务现代能源体系建设的使命与担当。

[返回目录](#)

## 喜讯！赛晶牵头编制的柔性直流输电领域 材料团体标准通过报批稿评审

2025年8月26日，由无锡赛晶电力电容器有限公司牵头，联合清华大学、西安高压电器研究院股份有限公司以及代表国内拉膜、镀膜企业等10家单位共同编制的团体标准《柔性直流输电直流电容器用金属化薄膜电气性能与评价方法》

（项目编号：CESBZ2024018），顺利通过中国电工技术学会报批稿评审！这一成果标志着我国在柔性直流输电直流电容器核心材料在标准化领域迈出关键一步，具有里程碑意义，也彰显了赛晶科技集团在电力设备核心技术研发与标准制定领域的领先实力。



返回目录

## Astrol再获核聚变脉冲电源订单！

2025年9月，赛晶科技集团有限公司（0580.HK）位于瑞士的子公司-Astrol Electronic AG（简称 Astrol公司）宣布与核聚变领域一家屡获殊荣的创新企业开启新合作。该客户将采用Astrol公司行业领先的功率开关解决方案，用于控制尖端核聚变系统中的电流。



截至目前，Astrol公司已经累计为高能粒子研究、脉冲实验室等超过80个各类项目，提供了脉冲功率开关产品和方案，其中包括了Tri Alpha Energy（2017年），以及另一家客户（2022年）在可控核聚变领域的项目。

[返回目录](#)

# 赛晶固态直流断路器护航海上风电安装船， 引领行业绿色升级

2025年7月，赛晶科技瑞士子公司Astrol传来喜讯——与欧洲知名船舶系统集成商Kongsberg Maritime合作，为海上风电安装的电气化与数字化进程做出贡献，满足了现代海上作业的高性能需求。其中Astrol公司的1.5kV/3kA固态直流断路器凭借超快速故障隔离能力，为该系统提供了坚实的安全保障。



[返回目录](#)

## 赛晶电力电容器再传捷报 三揽国网集中规模招标项目

2025年7月，赛晶电力电容器再传捷报，赛晶科技旗下子公司无锡赛晶电力电容器有限公司（以下简称：无锡赛晶）中标“国家电网2025第三次集招项目”，中标金额4391.6373万元，位列第三。加之上半年先后中标的“国家电网2025年第一次集招项目”、“国家电网2025第二次集招项目”，三次中标总额达1.3575亿元。



无锡赛晶已连续三次稳居行业前列，这不仅彰显了国家电网对无锡赛晶产品质量、技术实力与服务能力的高度认可，也是对赛晶在直流输电领域自主创新能力的高度肯定。作为高压、特高压直流输电电容器领域的佼佼者，无锡赛晶累计为多项重大工程提供数千万千乏电力电容器。

未来，无锡赛晶仍将坚守“以科技创新推动绿色能源发展”使命，持续助力国家电力事业，再创辉煌！

[返回目录](#)

## 赛晶科技亮相雁栖能源论坛 展示直流支撑电容器尖端成果

2025年7月31日，2025雁栖能源论坛在北京雁栖湖国际会展中心隆重举行。作为该论坛的协办单位，赛晶科技董事会主席项颉先生、副总裁李金燕先生及多位公司领导专家出席本次盛会。

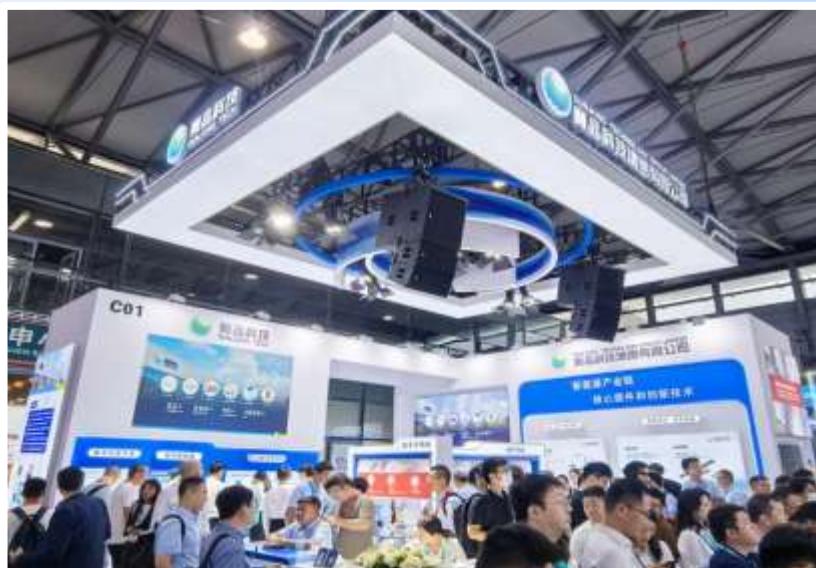


在2025雁栖能源论坛上，赛晶科技彰显了在电力电子领域的领先技术，并与全球合作伙伴深入交流，共同探索未来能源发展的前沿趋势。未来，赛晶科技将继续不断创新，与行业伙伴共建创新生态，为保障国家能源安全和实现“双碳”战略目标做出更大的贡献。

[返回目录](#)

## 创新驱动，绿色未来 赛晶科技参加PCIM Asia 2025

2025年9月24日，上海国际电力元件、可再生能源管理展览会（PCIM Asia 2025）在上海隆重开幕。作为亚太地区最具影响力的功率半导体行业盛会，本届展会汇聚了全球顶尖企业和技术专家。赛晶科技以“创新驱动，绿色未来”为主题，携最新研发成果及多款自主研发的核心产品亮相，全面展示了其在功率半导体和电力电子领域的技术实力与创新成果。



赛晶科技表示，未来将继续坚持技术创新，紧跟全球能源转型趋势，致力于为新能源、工业控制等领域提供更高效、更可靠的解决方案。公司将持续加大研发投入，深化国际合作，推动功率半导体技术的进步与应用创新，为全球绿色能源发展贡献力量。

[返回目录](#)

## 赛晶半导体携“芯”技术参加IPF 2025

2025年8月21日-22日，“功率器件制造测试与应用大会(第三届IPF 2025)”在无锡盛大启幕。深耕高端功率器件领域的赛晶亚太半导体，延续去年参展的行业热度，今年再度亮相这一核心平台，以技术实力为盛会增添创新活力。

此次再度参展IPF功率半导体大会，赛晶亚太半导体带来了更多前沿产品与解决方案。大会聚焦“材料提质、装备升级、智造增效”，旨在推动中国功率半导体产业实现技术突破、制造升级与生态协同。



返回目录

# 新品发布

## i23系列微沟槽栅IGBT芯片

2025年7月，赛晶科技发布i23系列芯片，该系列芯片采用微沟槽栅IGBT技术，具有更低的饱和压降（ $V_{ce(sat)}$ ）和更高的电流密度，同时可以降低开关损耗，符合业界最高的可靠性标准和要求。d23系列芯片具有更低的正向导通压降和反向恢复损耗。i23芯片和d23芯片的配合使用，能够有效使得模块的性能提升，并保证模块的可靠性。



[返回目录](#)

## 1200V i23 ED封装半桥IGBT模块



2025年7月，赛晶科技发布i23 900A/1200V系列模块，该系列模块能够有效降低饱和压降和开关损耗，符合业界最高的可靠性标准和要求，助力实现高能效的新能源发电和工控等领域的设计方案。该系列产品采用最新的封装技术，以实现i23高电流密度的优异性能，同时降低模块的内部阻抗，使得模块能够承载更大的系统电流，满足更为广泛的应用需求。

## 1700V i20 TF封装半桥IGBT模块

2025年8月，赛晶科技发布i20 系列TF模块，该系列模块采用工业标准34mm 封装，提供1700V 75A、100A、150A 规格。该系列模块通过优化设计，显著提升了焊料层的稳定性与工艺可控性，进而增强了器件的温度循环可靠性。其独特的对称芯片布局设计，实现了上下桥臂开关特性的高度一致性，有效降低了模块的寄生电感与电容，优化了开关性能。这些特性共同作用，大幅提高了系统的整体可靠性，显著增强了终端产品的市场竞争力。



[返回目录](#)

## 1700V 900A i23 ED封装半桥IGBT模块

2025年8月，赛晶科技发布i23 1700V 900A系列IGBT模块，该系列模块采用经典ED封装，i23芯片采用微精细沟槽栅技术，实现超低损耗 $E_{on}+E_{off}$ ，同时也具有高短路能力，以解决芯片高电流密度面临的挑战。支持长期运行结温175°C (T<sub>vjop</sub>)，集成NTC温度传感器，确保高温工况下的稳定运行，显著增加了器件的输出能力，大幅提高系统的功率密度，为风电、工控和新能源等领域带来突破性的解决方案。



## 1200V 200A /300A ST封装半桥IGBT模块



2025年8月，赛晶科技发布i20 1200V 200A/300A系列IGBT模块，该系列模块采用成熟的ST封装半桥拓扑设计，具有出色的温度循环能力，将运行结温提升至175°C显著提高了产品功率密度，从而拓展了散热设计的自由度。该模块配备的i20精细沟槽栅型IGBT芯片组可实现极高的电流密度，其超低的损耗给模块带来了出色的系统可靠性，其对称环流设计，使得模块具有更低的寄生参数及开关特性，高度对称并联的电路设计，更好的实现了均流特性。

## 联系我们

吉庆 Allan 投资者关系总监

电话: +86 186 1169 3787

邮箱: [jq@sunking-tech.com](mailto:jq@sunking-tech.com)

王泽 Cody 投资者关系助理

电话: +86 183 3216 9189

邮箱: [wangze@sunking-tech.com](mailto:wangze@sunking-tech.com)

官方网址: <https://www.sunking-tech.com/>



赛晶科技投资者关系  
微信公众号